LG Chem

MALZEME PASAPORTU

SÉETEC H7630

PP Homopolymer (Polipropilen Homopolimer)

Spunbond teknolojisiyle ince elyaf üretimi için özel olarak tasarlanmış; dar molekül ağırlığı dağılımı (MWD) ve anti-gaz solma stabilizasyonuna sahip yüksek performanslı reçine.

NotebookLM

Kritik Teknik Veriler

Akışkanlık (MFR)

25 g/10min

230°C, 2.16Kg (ASTM D1238)

Yoğunluk

0.9 g/cm³

ASTM D1505

Mekanik Güç

- Akma Mukavemeti: **34 MPa** (ASTM D638)
- Kopma Uzaması: **>%500** (ASTM D638)
- Eğilme Modülü: **1600 MPa** (ASTM D790)
- Darbe Dayanımı: **29 J/m** (Izod, 23°C)

Termal Dayanım

- Vicat Yumuşama (1kgf): **151 °C** (ASTM D1525)
- Isıl Eğilme (HDT 4.6kgf/cm²): **110 °C** (ASTM D648)

NotebookLM

En Uygun Uygulama Alanları

SÉETEC H7630, spunbond teknolojisinin kullanıldığı zorlu sektörlerde güvenle tercih edilir.



Hijyen Sektörü

İnce, yumuşak ve standartlara uygun dokumasız elyaf yapıları.



Medikal Endüstri

Güvenilir kalite ve gaz solma direnci gerektiren tıbbi tekstiller.



Endüstriyel Ürünler

Yüksek kopma uzaması (>%500) ve homojen dayanıklılık gerektiren uygulamalar.

NotebookLM

Neden SÉETEC H7630 Seçilmeli?

(Aşağıdaki üretim hedeflerinde bu ürün en yüksek performansı garantiler)



İnce Elyaf (Fine Fiber) Ekstrüzyonu

Spunbond teknolojisiyle kusursuz ve kesintisiz ince elyaf üretimi hedeflendiğinde.

Dar Molekül Ağırlığı Dağılımı (MWD)

Üretim prosesinde yüksek boyutsal kararlılık, homojenlik ve stabilite arandığında.

Anti-Gaz Solma (Anti-gas fading) Beklentisi

Ürünün çevresel etkilere ve gazlara karşı renk ve yapısal stabilitesini uzun süre koruması gerektiğinde.

NotebookLM

Hangi Durumlarda Uygun Değildir?

(TDS verilerine dayalı teknik kısıtlamalar)



Ağır Darbe Sönümleme Gerektiren Parçalarda

Izod darbe dayanımı 29 J/m seviyesindedir. Şiddetli darbe veya düşme testi gerektiren yapısal uygulamalar için formüle edilmemiştir.

Düşük Akışkanlık Arayışında

25 g/10min MFR değeriyle oldukça akışkandır. Şişirme kalıplama (blow molding) veya çok kalın kesitli ekstrüzyon proseslerine uygun değildir.

Yüksek Isıda Sürekli Yük Altında

Isıl eğilme sıcaklığı (HDT) 110 °C'dir. Bu derecenin üzerindeki mekanik stresli ve sürekli sıcak ortamlarda deformasyon riski taşır.

NotebookLM

Proses ve Teknik Notlar

Uygulama ve Test Öncesi Bilinmesi Gereken Kritik Parametreler

Test Koşulları

Teknik tablodaki tipik değerler, garanti edilen spesifikasyonlar değildir. Veriler, standart kompresyon kalıplama (compression molded) numuneleri üzerinden (ASTM standartları ile) elde edilmiştir.

Test Hızları

Mekanik testlerden Akma Mukavemeti 50 mm/dk, Eğilme Modülü ise 28 mm/dk hız ile ölçülmüştür.

Müşteri Sorumluluğu

Gerçek proses koşulları kontrolümüz dışındadır. Nihai ürünün kullanım koşullarındaki (end-use) uygunluğu ve performans testlerinin yapılması müşterinin sorumluluğundadır.

NotebookLM

Karar Özeti

“SÉETEC H7630; hijyen ve medikal uygulamalarında spunbond ince elyaf üretimine odaklanan, 25 MFR ile yüksek akışkanlık sağlayan ve anti-gaz solma özellikleriyle donatılmış yenilikçi bir PP Homopolimer çözümüdür.”

Uygulamanız için tam uyum sağlıyor mu?

Teknik destek, numune ve detaylı sipariş bilgileri için iletişime geçin:

TS&D TECH Center, Polyolefin Division | Tel: 82-42-860-8538 | Email: dbdefault@lgchem.com

LG Chem

NotebookLM